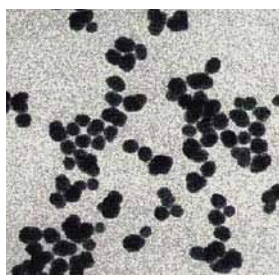
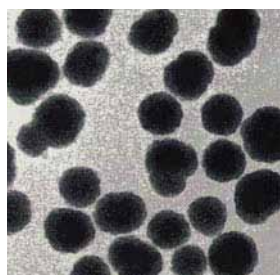


PLANERLITE

Химико-механическая планаризация



PLANERLITE-7101



PLANERLITE-4101



This photograph is an image.
На данной фотографии представлено изображение изделия.

PLANERLITE

The PLANERLITE series of polishing slurries is intended for use in chemical mechanical planarization (CMP), a key planarization process in the fabrication of high-density ULSI devices. It has been developed under the basic concepts of high purity, high removal rate, high dispersion and scratchfree performance.

PLANERLITE-4000 series

This polishing slurry is designed for use on SiO₂ films (interlayer dielectric, STI). Based on ultra-high purity colloidal silica or fumed silica, it is available in several grades with varying additives and abrasive particle concentration, enabling users to select the product optimal for their specific process parameters and cost/performance requirements.

PLANERLITE-6000 series

This polishing slurry is designed for use with polysilicon. There is a variety of types available, either polishing slurry based on ultra-high purity colloidal silica or rinsing agent with special additives which keeps post-polishing wafer surface hydrophilic. The polishing slurry, in all types has extremely high polysilicon removal rate with excellent selectivity to silicon oxide film. The rinsing agent helps prevent particle adhesion, simplifying wafer cleaning process. The entire line can be used at high dilutions, and adjustment of the dilution provides control of removal rate and selectivity while also delivering high cost/performance. Abrasive particles are completely dispersed, eliminating sedimentation in a high stable slurry.

PLANERLITE

Линейка полировальных паст PLANERLITE предназначена для использования в химико-механической планаризации — ключевом процессе планаризации при изготовлении устройств со сверхбольшими интегральными схемами высокой плотности. При разработке паст преследовались такие главные цели, как чистота, высокий съем материала, высокая дисперсия и отсутствие царапин.

Серия PLANERLITE-4000

Эта полировальная паста применяется для пленок SiO₂ (межслойный диэлектрик, изоляция мелкими канавками). Изготавливается на основе коллоидальной двуокиси кремния или высокодисперсной двуокиси кремния и доступна в нескольких вариантах, отличающихся добавками и концентрацией абразивных зерен, что позволяет пользователям выбрать оптимальное изделие в соответствии со своими технологическими параметрами и нужным соотношением «затраты — производительность».

Серия PLANERLITE-6000

Данная полировальная паста предназначена для использования с поликристаллическим кремнием. Она доступна в различных вариантах, в т. ч. в виде полировальной пасты на основе сверхчистой коллоидальной двуокиси кремния или в виде средства для промывки со специальными добавками, которые поддерживают гидрофильные свойства поверхности полупроводниковой пластины после полировки. Все типы полировальной пасты отличаются чрезвычайно высокими характеристиками схода материала для поликристаллического кремния, а также превосходной избирательностью по отношению к кремнийоксидной пленке. Средство для промывки предотвращает приклеивание частиц, упрощая процесс очистки полупроводниковой пластины. Все изделия линейки могут использоваться при высоких степенях разбавления; изменение степени разбавления позволяет контролировать съем материала и избирательность, а также обеспечивает отличное соотношение «затраты — производительность». Зерна абразива полностью диспергируются, не образуя осадка и создавая, таким образом, высокостабильную суспензию.

■ PLANERLITE

PLANERLITE-7000 series

This polishing slurry is designed specifically for Cu metallization in the damascene process. Based on ultra high purity colloidal silica with special additives, it delivers high copper removal rate, with excellent selectivity to barrier metal. As a result, erosion is low and residual copper on the barrier metal is minimal, making it possible to completely stable, with no sedimentation, and minimal scratching. We also offer a high-dilution type, contributing to lower cost for copper damascene process.

PLANERLITE-8000 series

This polishing slurry is designed for barrier metal in the Cu interconnection. Based on ultra purity colloidal silica with special additives, it delivers enough barrier metal removal rate with planarity to be kept by designed selectivity. Also it delivers minimal scratch and minimal roughness, as ideal polishing slurry.

■ PLANERLITE

Серия PLANERLITE-7000

Данная полировальная паста предназначена специально для медной металлизации в дамасском процессе. Она изготавливается на основе коллоидальной двуокиси кремния сверхвысокой чистоты и обеспечивает высокий съём объема меди, а также превосходную избирательность в отношении барьерного металла. В результате достигается низкая эрозия и минимальное остаточное содержание меди на барьерном металле, обеспечивая полную стабильность процесса, отсутствие осаждения и минимум царапин. Также мы предлагаем средства с высокой степенью разбавления, что помогает обеспечить низкую стоимость дамасского процесса при формировании медной разводки.

Серия PLANERLITE-8000

Данная полировальная паста предназначена для барьерных металлов при выполнении медной разводки. Она изготавливается на основе коллоидальной двуокиси кремния сверхвысокой чистоты и обеспечивает достаточную степень съема барьерных металлов, а расчетная избирательность поддерживает необходимую плоскостность. Также данное изделие как идеальная полировальная паста гарантирует минимум царапин и самую низкую шероховатость.